



日本シイエムケイ株式会社
(証券コード：6958)

中期経営計画

2021年 11月24日

日本シイエムケイ株式会社

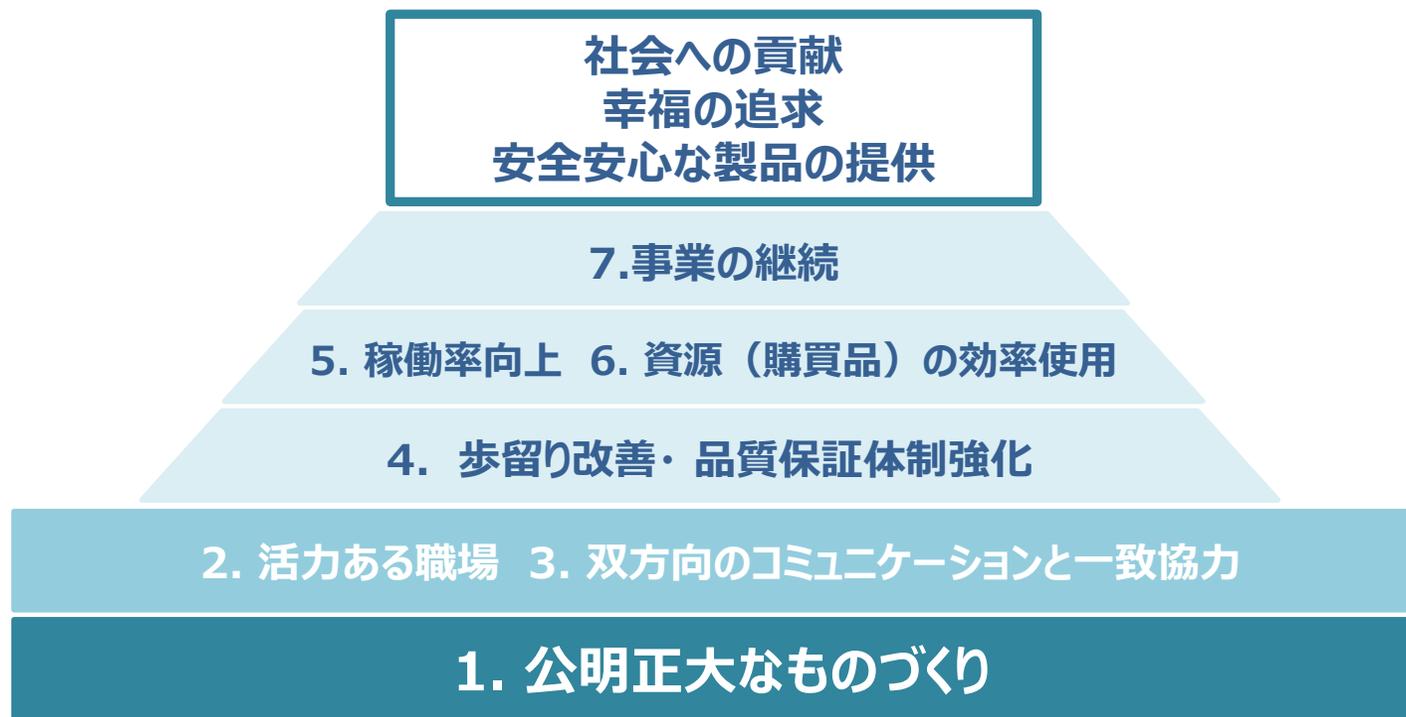
- ◆ 中長期ビジョンと経営方針
- ◆ 前中期経営計画の振り返り
- ◆ 現状認識と中期経営計画の方針
- ◆ 中期経営計画の骨子
- ◆ 中期経営計画の達成に向けて
- ◆ 第1次中期経営計画
 - ・生産効率化
 - ・高付加価値化シフト
 - ・設備投資
 - ・営業利益増減分析
 - ・成長への仕込み、事業化加速
- ◆ 第2次中期経営計画
 - ・既存事業領域の拡大
 - ・新規事業領域の拡大
 - ・成長加速に向けた生産体制
- ◆ 数値目標
- ◆ 持続可能な社会に向けた取り組み
- ◆ 補足資料
 - ・市場動向、技術ロードマップ等

1. 中長期ビジョンと経営方針

中長期ビジョン：

新たな社会・価値観に適応した『世界最高レベルの安全安心なプリント配線板』を供給し続けることにより、安全で快適な社会を実現する

経営方針：



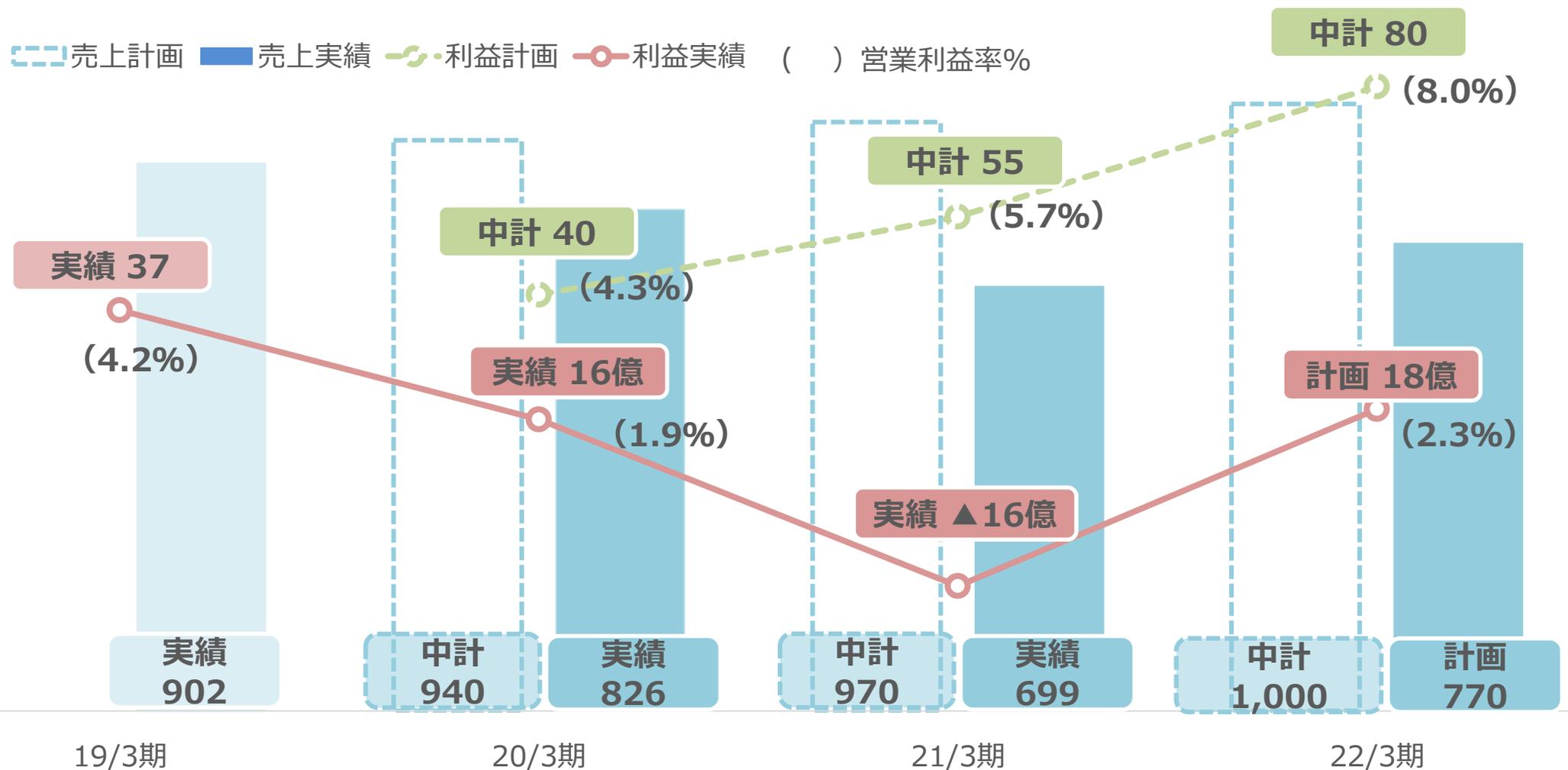
実現のために

持続的な成長に向けて、
『安定的な収益構造の構築』と『成長サイクルの確立』を目指す

2. 前中期経営計画の振り返り

米中貿易摩擦などの影響による車載市場の減速に加え、コロナによる車載向け受注急減という外部環境の大きな変化により2020年6月に定量目標は取り下げ

(単位：億円)



3. 現状認識と中期経営計画の方針

現状認識

- コロナ影響で車載向け売上高は一時的に大幅減少したものの、前中期経営計画の施策及び、コロナ禍における経営合理化策の取組みにより、収益構造は改善しつつある
- 持続的な成長を目指せる収益構造には更なる事業構造改革が必要
- 新規事業領域への開発投資などにより中期的な成長戦略への布石は打った

事業環境に対する理解

- サステナブルな社会の実現に向けて電動車の高い成長率が見込まれ、車載プリント配線板市場は、中長期的に大きな成長余地がある（CASE需要）
- 汎用車載プリント配線板は、競合他社の生産能力拡大等により競争が激化
- 5G普及により通信向けプリント配線板との技術的な融合が進む

中期経営計画の方針

- **生産効率化、車載製品ポートフォリオの更なる高付加価値シフトによる、安定的な収益構造を構築**
- **安定的な収益構造をベースに、CASE需要と新規事業領域の取込みによる成長サイクルを確立し、持続的な成長を目指す**

4. 中期経営計画の骨子

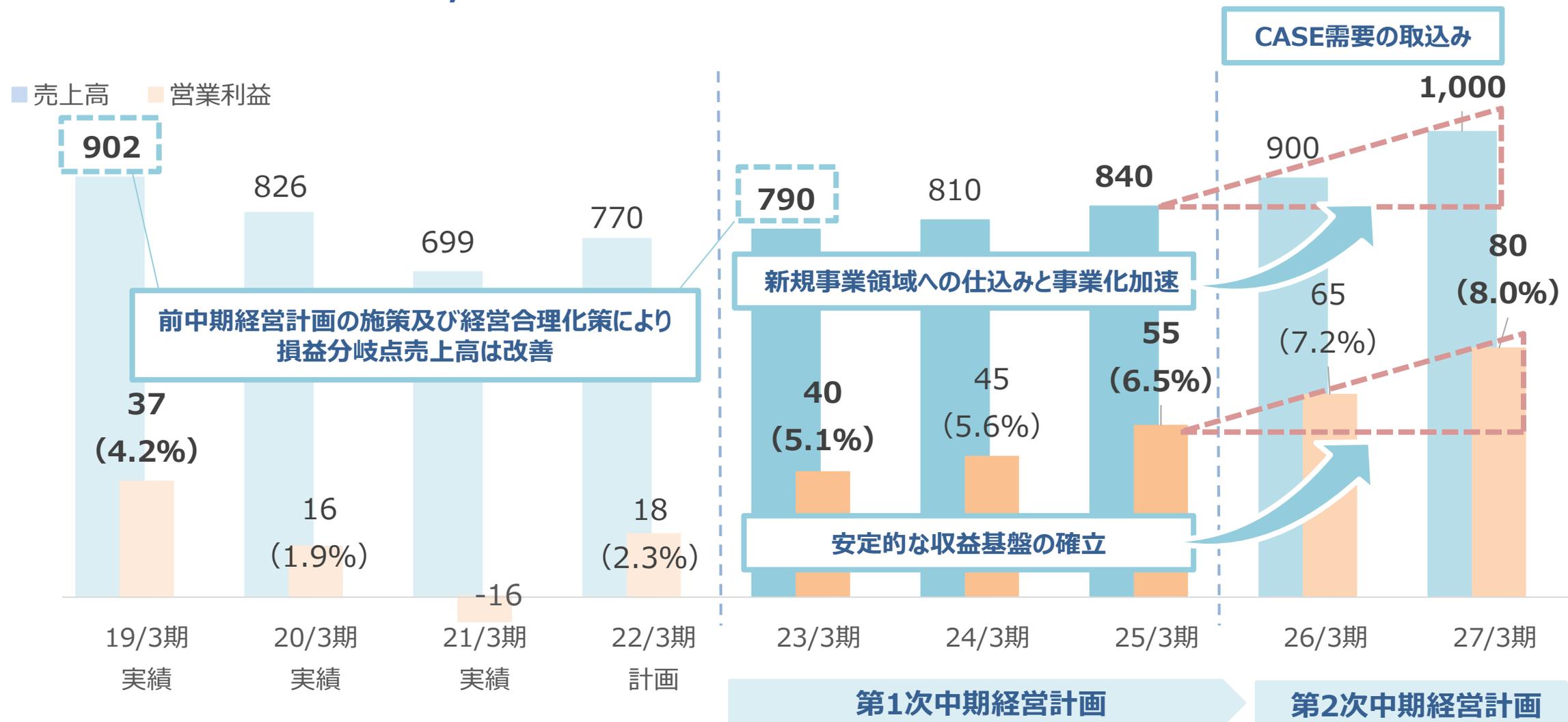
第1次中期経営計画：事業構造改革による収益基盤の確立と次なる成長への仕込み

第2次中期経営計画：CASE需要と新規事業領域の取込みによる成長加速

第1次中期経営計画 (2023/3月期～2025/3月期)	第2次中期経営計画 (2026/3月期～2027/3月期)
<div data-bbox="196 665 1480 776" style="text-align: center; background-color: #4a7ebb; color: white; padding: 10px; border-radius: 5px;"> 収益基盤の確立、成長への仕込み </div> <ul style="list-style-type: none"> ・事業構造改革による生産効率化 ・車載製品ポートフォリオの高付加価値シフト (プロダクトミックス改善) ・新規事業領域への仕込みと事業化加速 	<div data-bbox="1646 665 2328 776" style="text-align: center; background-color: #4a7ebb; color: white; padding: 10px; border-radius: 5px;"> 成長加速 </div> <ul style="list-style-type: none"> ・CASE需要の取込みによる成長サイクルの確立 ・新規事業領域の取込み

5. 中期経営計画達成に向けて

2027年3月期 売上高1,000億円、営業利益80億円に向けたロードマップ[°] (単位：億円)





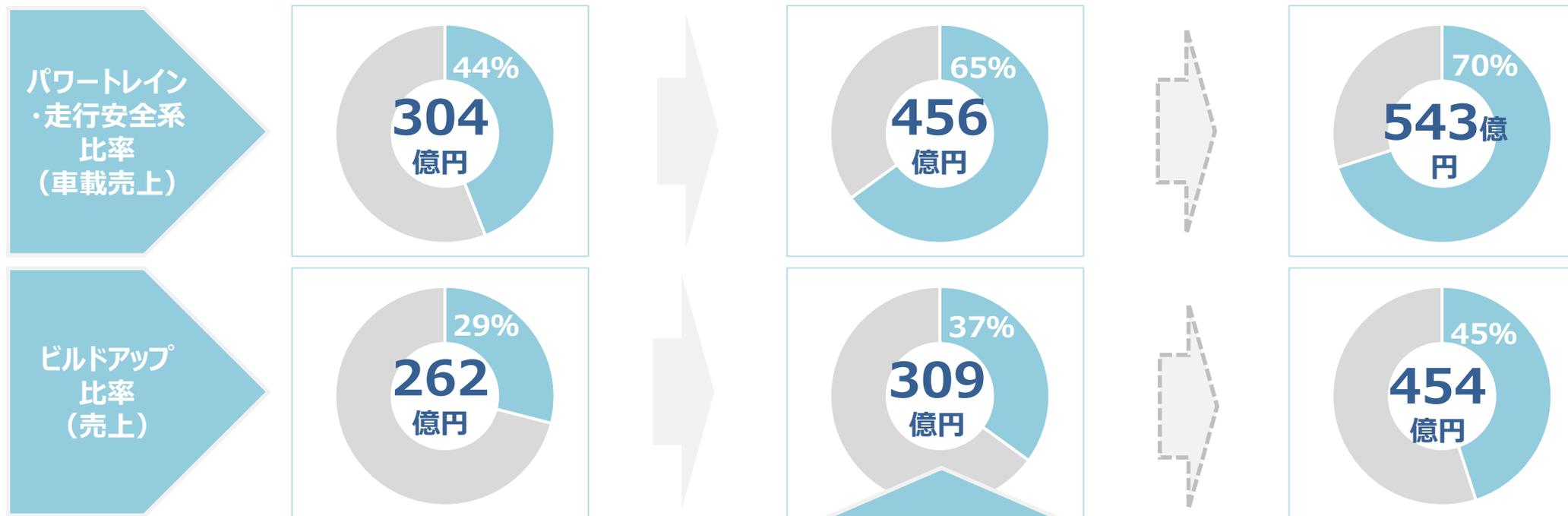
7. 第1次中期経営計画：高付加価値シフト

車載製品ポートフォリオの高付加価値シフト・プロダクトミックス改善による収益性向上
 ⇒競争優位性のあるパワートレイン・走行安全に注力、ビルドアップ比率UP

19/3期実績

25/3期中計

27/3期中計



生産体制のモデルチェンジ

- ・タイ工場のビルドアップ生産比率の引き上げ、中国工場のファイン化
- ・汎用車載プリント配線板のファブライト化推進

* ファブライト化：製造を外部委託すること (OEM)

8. 第1次中期経営計画：設備投資



設備投資総額240億円を実施

<投資金額>

<投資内容>

<投資目的>

生産設備

210億円

- ✓ 自動化投資
- ✓ 更新投資（品質向上など）
- ✓ 国内生産体制の集約、再編

▶ **生産効率化**

- ✓ 生産体制のモデルチェンジ

▶ **高付加価値シフト**

開発・その他

30億円

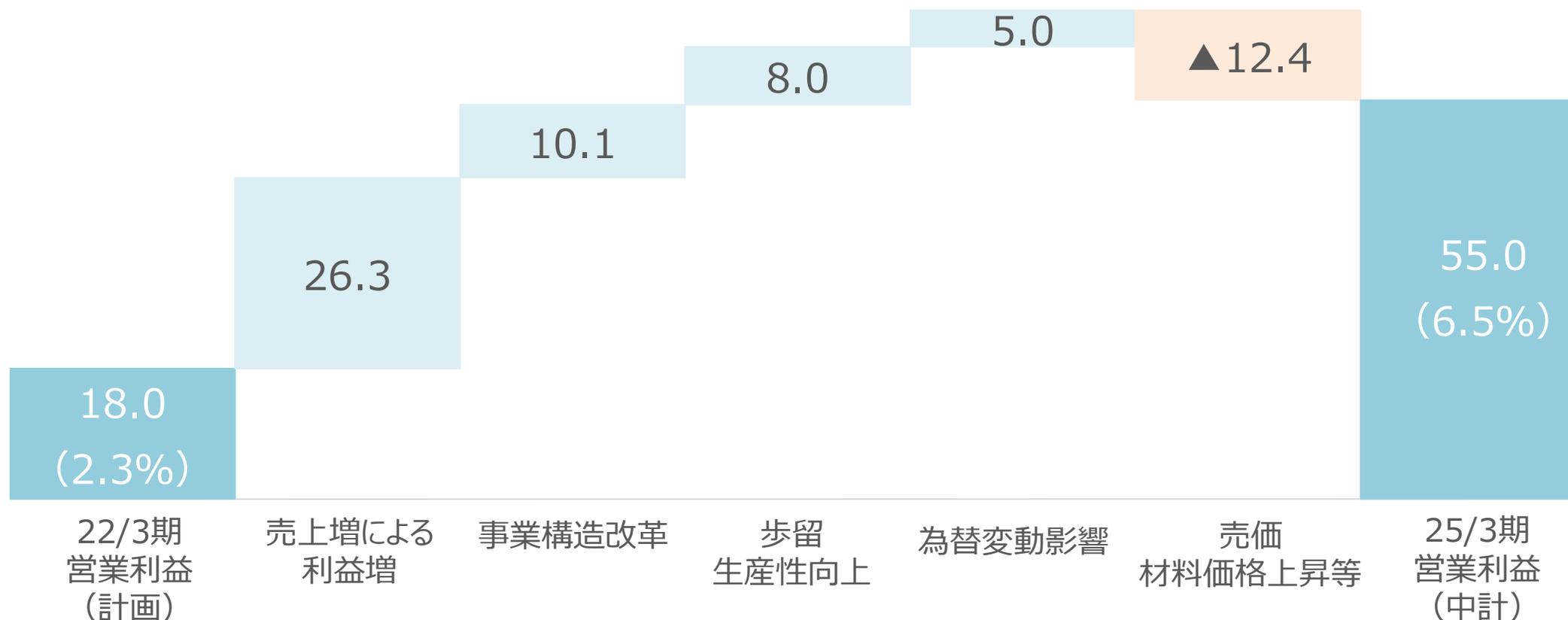
- ✓ 研究開発投資
- ✓ システム投資、その他

—

9. 第1次中期経営計画：営業利益増減分析

22/3期⇒25/3期 営業利益：18億⇒55億
 営業利益率：2.3%⇒6.5%

(単位：億円)



10. 第1次中期経営計画：成長への仕込み・事業化加速



新規事業領域への仕込みと事業化加速

【研究開発拠点概要】

名称：CMKイノベーションセンター

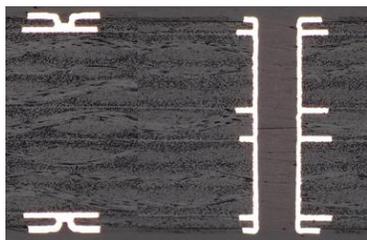
拠点：新潟工場

目的：5G通信等の技術革新に伴う通信関連分野及び、
次世代車載プリント配線板に求められる要素技術の確立

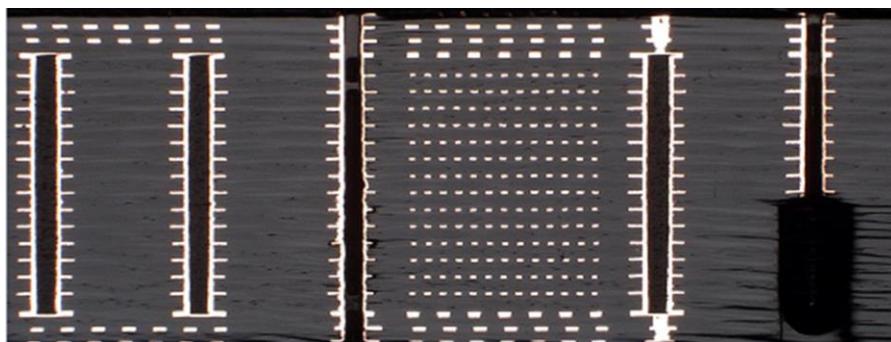
その他：多品種少量生産思想を取り入れたモデルラインの構築



(参考) 一般構造

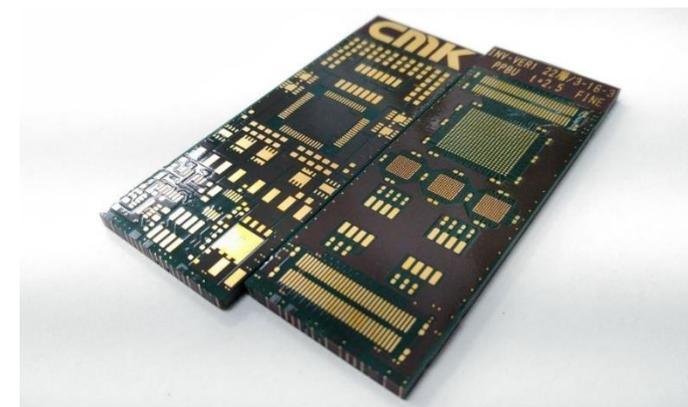


6層/1段ビルトアップ
TH0.30mm/板厚1.6mm



22層/3段ビルトアップ
TH0.15mm/板厚2.5mm /ハットドリル

構造



22層(3-16-3) ハイアスペクト基板

11. 第2次中期経営計画：既存事業領域の拡大



CASE需要の取込みによる成長サイクルの確立

C

Connected 5G通信との連携

ネットワークとつながることで、自動車とIoT社会との連携が始まる。

▶ 新規事業領域の技術とコラボレーション

<ターゲットアイテム>

通信モジュール(セルラー)、衛星測位システム・狭域通信モジュール、DCM(データコミュニケーションモジュール)、アンテナモジュール など

Autonomous

情報収集による自動運転化

自動運転社会の到来で、安心・安全・便利が深まる

A

▶ 統合ECUに向けた次世代車載PCBの供給

<ターゲットアイテム>

統合ECU、カメラモジュール・画像センサー、ミリ波レーダー・LiDAR、自動ブレーキ、ドライバーサポートシステム など

S

Shared & Service 自動車の利活用変化

所有から利用へ広がることで、自動車が様々なサービスの土台となる。

<ターゲットアイテム>

スマートキー、非接触充電器 など

Electric

省エネ/環境への対応

HEV→EV→FCVと進むことで、自動車がエネルギーエコシステムの一翼を担う

E

▶ EV化に対し、競争優位性のある事業領域として車載製品ポートフォリオの柱

<ターゲットアイテム>

インバーター・DC-DCコンバーター、パワーコントロールユニット(PCU)、HEV/EV系ECU、駆動用二次電池(バッテリー) など

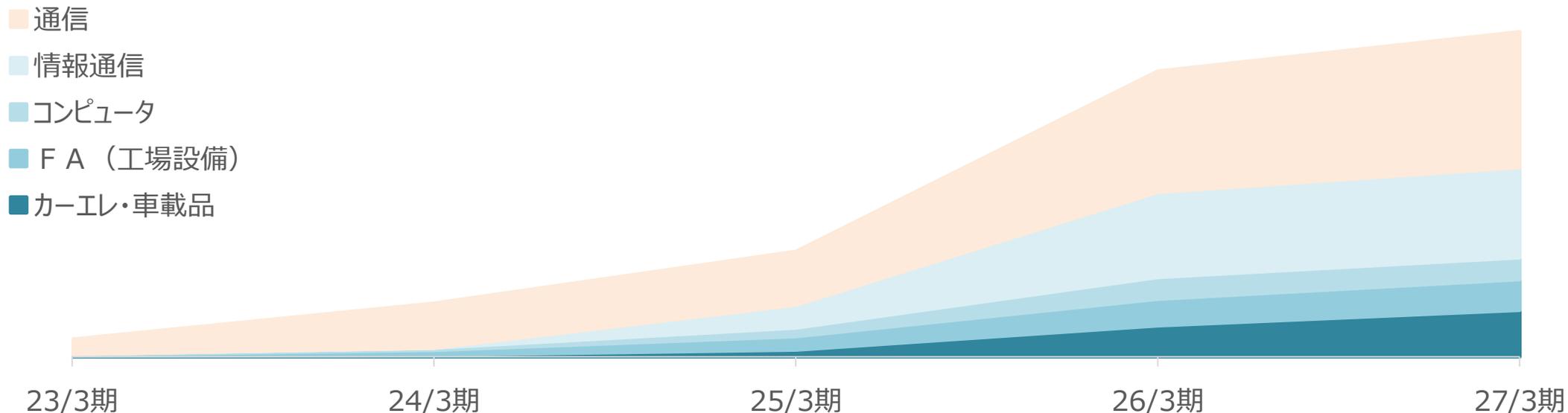
12. 第2次中期経営計画：新規事業領域の拡大



新規事業領域のターゲットアイテムと要求スペック

ターゲット
アイテム
(売上)

新規事業領域売上高構成イメージ



要求
スペック

ファイン化推進 高精度な回路形成技術 インピーダンス制御	
0.5mmピッチ BGA対応 (L/S:50/50μm)	0.4mmピッチ BGA対応 (L/S:30/30μm)
10層以上 ~2.4mm厚 (アスペクト比10)	16層以上 ~3.0mm厚 (アスペクト比15)
マクロセル サーバード 通信モジュールなど	スモールセル Local- 5 G関連(低誘電材料) 通信モジュール(スマホ技術+高周波技術) パワーモジュール セラミック代替 高耐熱・低弾性・特殊構造

13. 第2次中期経営計画：成長加速に向けた生産体制



日本

- ・新規事業領域を中心とした高多層ビルドアップ化

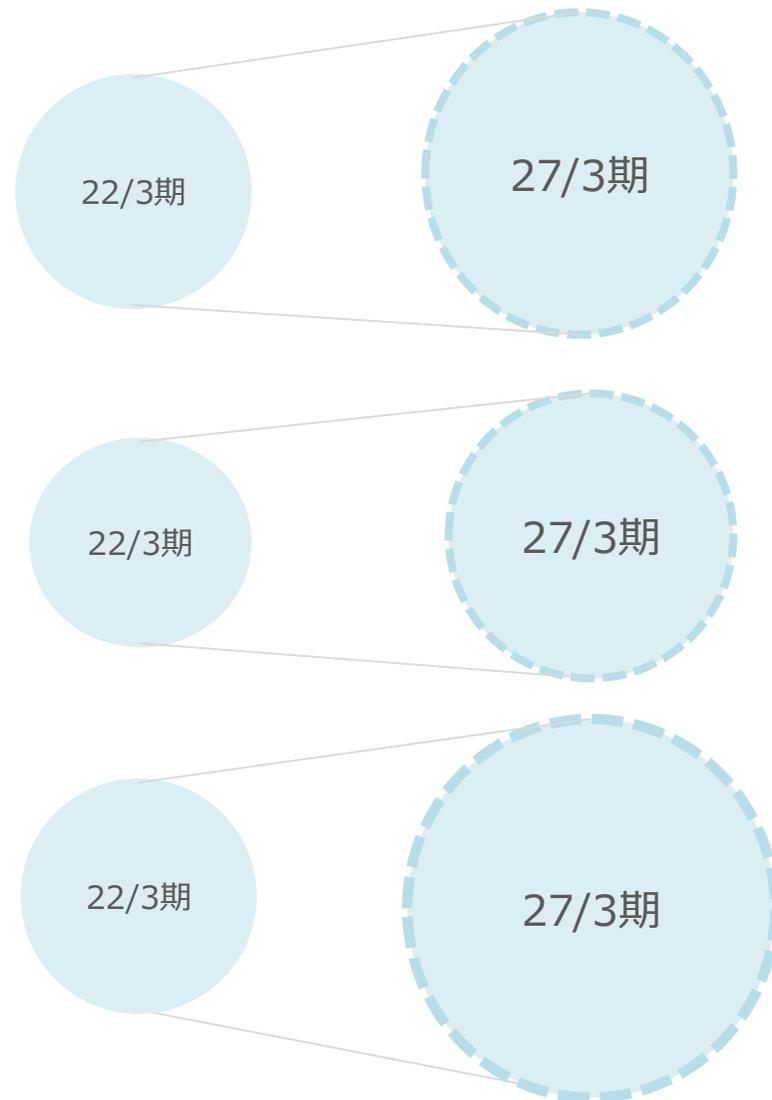
中国

- ・車載基板のビルドアップ、ファイン化
- ・アライアンス先との協業強化

タイ

- ・外資顧客を含めた車載基板のビルドアップ化

地域別 生産高イメージ



+ M&A・アライアンスによる成長加速

14. 中期経営計画 数値目標

売上高1,000億円、営業利益80億円、利益率8.0%、ROE9.0%

(億円)	第1次中期経営計画			第2次中期経営計画	
	23/3期	24/3期	25/3期	26/3期	27/3期
売上高	790	810	840	900	1,000
営業利益	40	45	55	65	80
率	5.1%	5.6%	6.5%	7.2%	8.0%
当期純利益	28	31	38	45	56
ROE	5.6%	6.0%	7.0%	7.7%	9.0%
減価償却費	45	50	54	59	63

- 配当：経営体質の強化と将来の事業展開のために必要な内部留保を確保しつつ、業績や財務状況等を勘案した上で、配当性向30%程度を目安に安定的な配当を継続して実施

15. 中期経営計画 数値目標～売上高内訳～



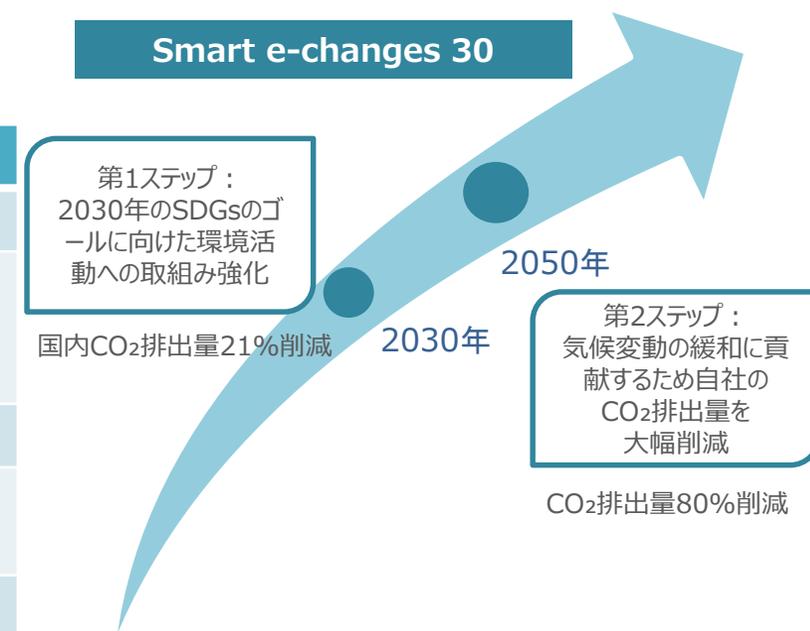
	25/3期		27/3期		増減	
	(億円)	構成比	(億円)	構成比	(億円)	構成比
車載	687	82%	785	79%	+98	-3%
パワートレイン・走行安全系	456	65%	543	70%	+87	+3%
ボディ・快適系	193	28%	204	26%	+11	-2%
情報通信系	37	5%	38	5%	+0	-1%
通信	17	2%	17	2%	+1	-
新規事業領域	27	3%	70	7%	+43	+4%
その他	110	13%	128	13%	+19	-
合計	840	100%	1,000	100%	+160	-

車載内訳

16. 持続可能な社会に向けた取組み

グローバルな環境課題を解決する一翼を担うべく、『中長期環境行動計画』“Smart e-changes 30”を掲げ、5つの取組みを推進中。

課題	活動内容
気候変動の緩和	・CO ₂ 削減のための省エネルギー活動等の推進
廃棄物削減 資源有効活用	・廃棄物の減量化のために分別回収を徹底 ・ゼロエミッション率100%を維持 ・水リサイクル推進
生物多様性保全	・地域に密着した生物多様性の保全活動の実施
環境負荷物質管理	・法規制および顧客要請への対応 ・EHS管理活動の継続
環境汚染防止	・環境リスク管理活動を実施



2021年10月29日 新市場区分における「プライム市場」選択申請

“Smart e-changes 30”など現在の持続可能な社会に向けた各種ESGの取組み内容について、下記スケジュールにて2021年6月改定後のコーポレートガバナンス・コードに則り取組み内容の見直し・充実を図る。

主な項目	スケジュール
サステナビリティ重要課題と取組み方針策定	2021年12月
気候変動への対応について、TCFD枠組みについて開示	2022年6月
TCFD対応のブラッシュアップ	2022年7月以降

* 持続可能な社会に向けた各種ESGの取組み内容詳細についてはCMK Reportに記載があります。

<https://www.cmk-corp.com/csr/report/>

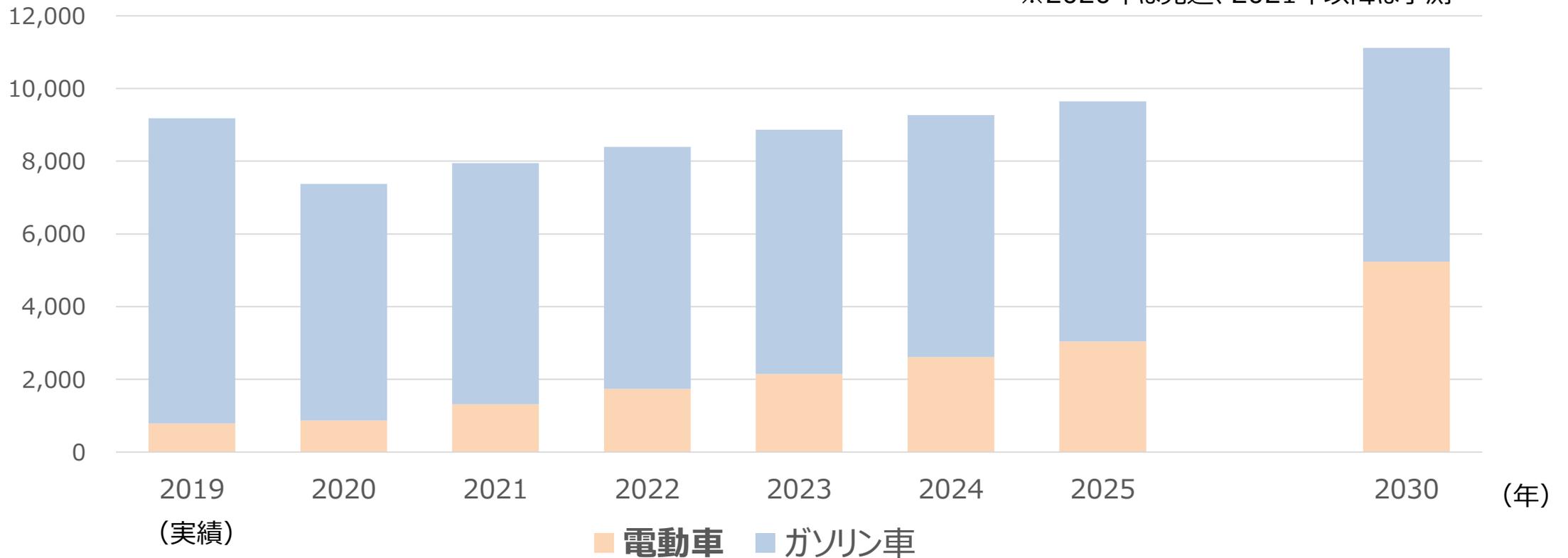
17. 補足資料

①世界自動車生産台数の市場規模予測

世界自動車生産台数予測

(単位：万台)

※2020年は見込、2021年以降は予測



▶ 電動車は2019-2030年の年平均成長率18.8%と高い成長率

②車載向けプリント配線板搭載動向（パワートレイン別販売予測）

分類	販売数量（千㎡）		CAGR (2030/2019)	コメント
	2019年実績	2030年予測		
エンジン車	39,600	30,570	▲2.3%	<ul style="list-style-type: none"> ・1台当たりの使用量はガソリン車0.5㎡程度、HVは1㎡弱、PHV/EV/FCVは1㎡以上 ・電動車は、低価格車への普及に伴い1台当たりのプリント配線板の使用量は減少していくが、全体の使用量は電動車の販売台数の伸びにより高い成長率で増加すると推測される
HV	4,760	25,360	16.4%	
PHV	880	11,340	26.2%	
EV	1,960	14,620	20.0%	
FCV	僅少	1,000	-	
合計	47,200	82,890	5.3%	

▶HV・PHV・EV向けにプリント配線板搭載が大幅に増加

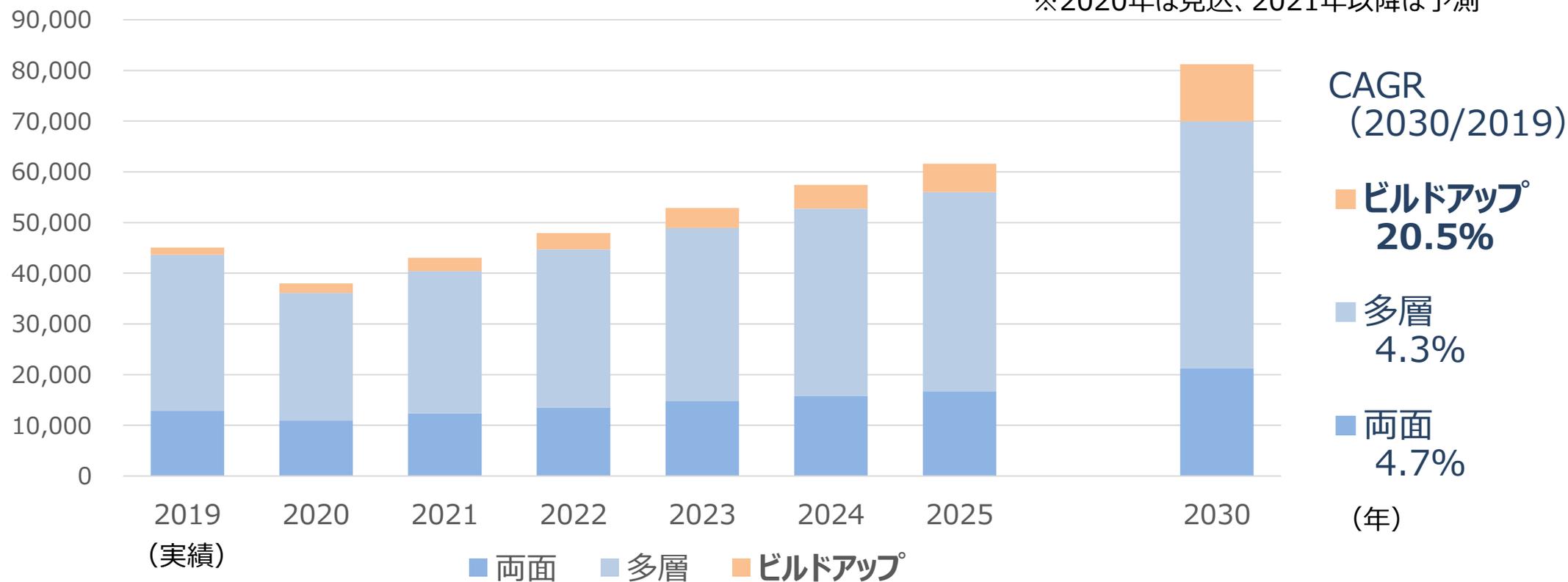
③車載向けプリント配線板市場動向（基板種類別販売予測）



車載向けプリント配線板/基板種類別販売予測

(単位：千㎡)

※2020年は見込、2021年以降は予測



▶ 需要の増加に対してビルドアップ配線板のニーズが高まる

④技術ロードマップ

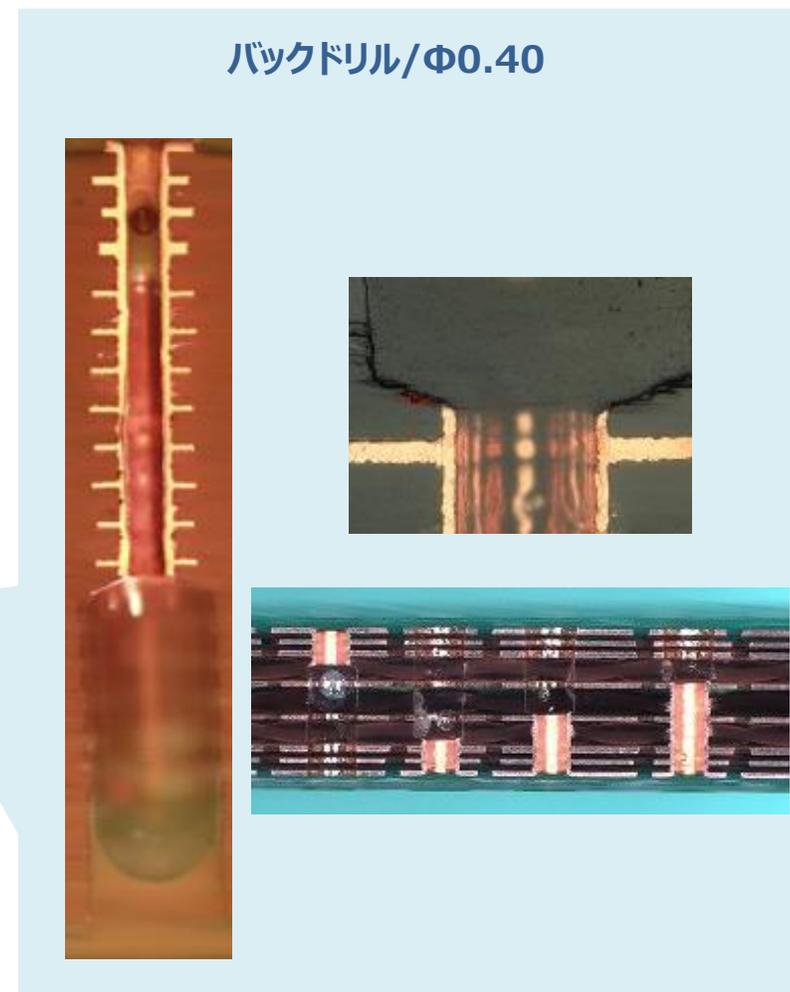
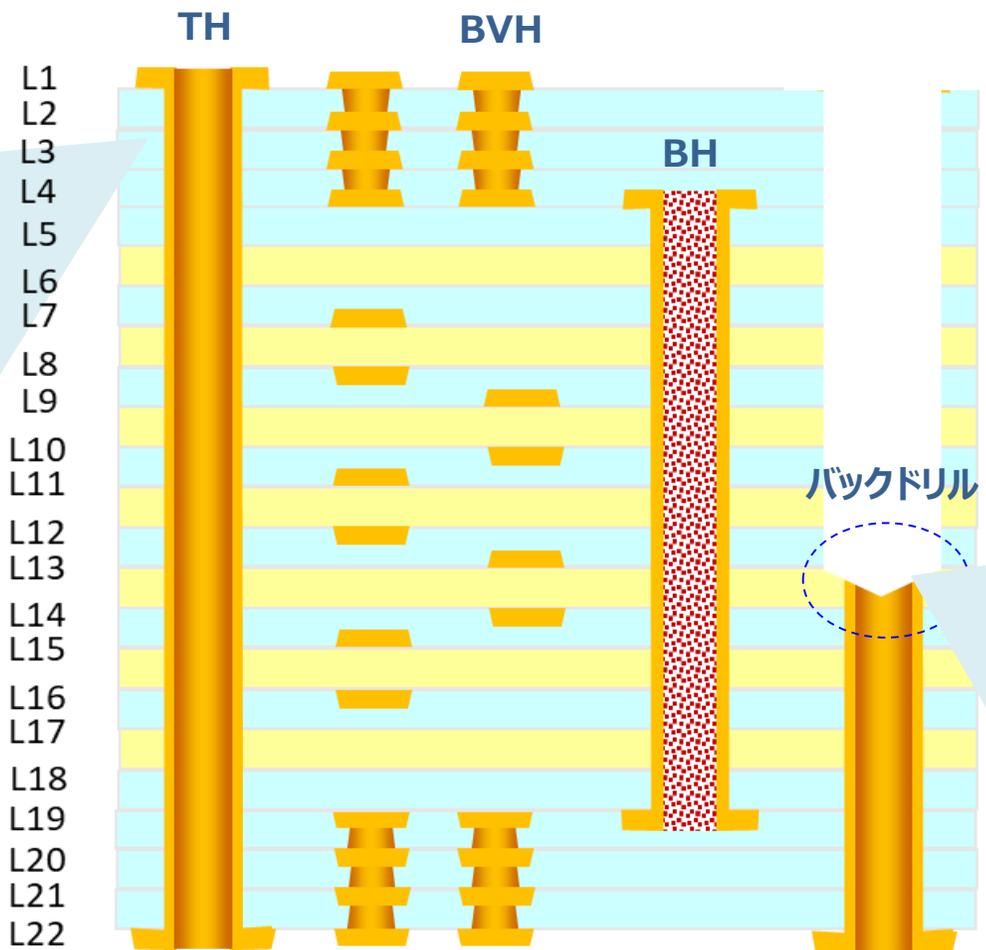
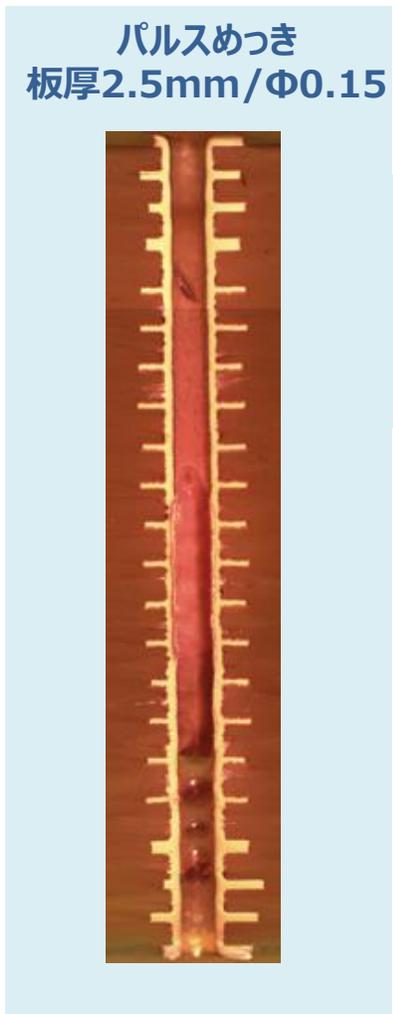


車載用途	アイテム類	市場ニーズ	基板要求	2022年	2023年	2024年	2025年以降	
Electric (電動化)	HEV/EV系ECU PCU/IPM ブレーキECU バッテリー制御 インバータ	<ul style="list-style-type: none"> ・ユニットの小型化 (HDI : PPBU) ・高耐熱化 (民生品の1.5倍超) ・大電流化、高電圧化 (PHV・EV用、インバータ、コイル等) ・高放熱化 (プリント配線板を介しての放熱) 	HDI	量産中				
			HDI次世代	試作	量産			
		厚銅	試作	量産				
		厚銅	開発	試作				量産
ADAS (先進運転支援) Autonomous (自動運転) ↓ ↓ ↓ Shared Connected 【5G連携】	ミリ波レーダ センサ	<ul style="list-style-type: none"> ・ユニットの小型化 (HDI : PPBU) ・アンテナ精度向上と安定化 (回路精度向上) ・低損失化 (低損失材料適用) ・次世代モデルに向けた高機能化 	HDI	量産中				
			MSAP	試作	量産			
			MSAP次世代	開発	試作			
	センシングカメラ	<ul style="list-style-type: none"> ・ユニットの小型化 (HDI : PPBU) ・高機能化 (車載カメラ対応厚型RF) ※RF : リッド・スワッス 	HDI	量産中				
			高板厚RF	試作	量産			
通信モジュール (DCM・V2X)	<ul style="list-style-type: none"> ・多ピンプロセッサ搭載 (ファイン化、多段HDI化) ・多ピンプロセッサ搭載モジュール (高信頼性、ファイン化、多段HDI化) ・多機能モジュール搭載基板 (高信頼性、ファイン化) 	多段HDI	試作	量産				
		多段HDI	開発	試作				量産
統合ECU ゾーンECU	<ul style="list-style-type: none"> ・多ピンプロセッサ搭載モジュール (高信頼性、ファイン化、多段HDI化) ・多機能モジュール搭載基板 (高信頼性、ファイン化) 	貫通FINE	開発	試作				量産
		貫通FINE	開発	試作				量産
5G通信	アンテナ/モジュール	<ul style="list-style-type: none"> ・通信関連機器向けモジュール (5Gインフラ/ Local-5G含) 	低損失 放熱	試作	量産			

▶5G通信を含むCASEへの対応：ビルドアップ（HDI）のファイン/多段化による高機能・高信頼性要求に対応 23

⑤22層 (3-16-3) ハイアスペクト基板

22層 (3-16-3) 、板厚2.5mm 穴径φ0.15、アスペクト16



本資料における将来情報は、2021年11月時点での見通しであり、
その実現を保証するものではありません。

(金額は切捨て、%は小数第二位を四捨五入にて表示)

END